A large, stylized graphic of the Intel logo, composed of multiple overlapping, concentric diamond shapes. The central diamond is bright yellow, and the surrounding layers transition through various shades of blue, from light to dark. The background is black.

Итоги 2021 года для Корпорации Интел и планы на будущее

Дмитрий Матчин

Менеджер по работе с партнерами, Inside Sales EMEA

15 декабря 2021, DC Link Partner Day 2021

intel®

Отказ от ответственности

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ ИХ РЫНОЧНЫХ КАЧЕСТВ, НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОРПОРАЦИЯ INTEL ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОСТАНОВКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ), ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ ФАКТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЧТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НА ТЕ СЛУЧАИ, КОГДА КОРПОРАЦИЯ INTEL БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ НАНЕСЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА. УЧИТЫВАЯ, ЧТО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ В РЯДЕ ЮРИСДИКЦИЙ, НЕ ДОПУСКАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОБОЧНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ИЗЛОЖЕННОЕ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕТ К ВАМ НЕ ОТНОСИТЬСЯ.

Корпорация Intel и ее поставщики не гарантируют точности или полноты текстовой или графической информации, ссылок и иного содержания материалов. Корпорация Intel вправе в любое время и без предварительного уведомления вносить любые изменения в указанные материалы, а равно и в продукцию, описанием которой они служат. Корпорация Intel не берет на себя каких-либо обязательств по обновлению материалов.

Информация о тестах производительности предназначена исключительно для специалистов в области компьютерной техники и программного обеспечения, обладающих соответствующими техническими знаниями. Покупателям при приобретении компьютерных систем или компонентов помимо производительности следует также учитывать и иные характеристики соответствующих систем и компонентов.

Тесты производительности и рейтинги измерены на конкретных компьютерных системах и/или компонентах и отражают приблизительную производительность продуктов корпорации Intel в единицах данных тестов. Любое отличие в аппаратных или программных компонентах или конфигурации может повлиять на результаты измерений. Дополнительную информацию по тестам производительности и производительности продуктов корпорации Intel можно узнать по адресу: http://www.intel.com/performance/resources/benchmark_limitations.htm

Тесты третьих сторон: корпорация Intel не контролирует и не проверяет проведение и результаты тестов третьих сторон или публикации результатов тестов в интернете на которые есть ссылки в этой презентации. Корпорация Intel предлагает всем заинтересованным посетить указанные интернет-страницы и убедиться в том что данные тестов точно отражают производительность систем предлагаемых на рынке.

Программа

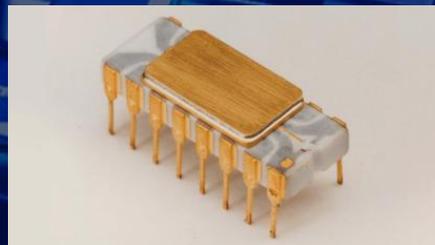
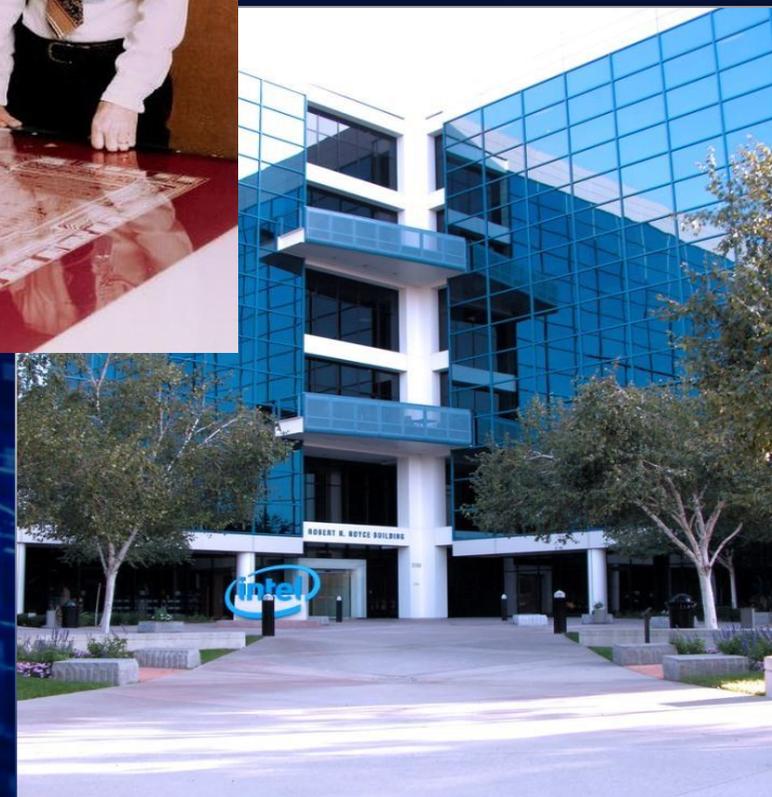
- Новости корпорации Интел
- Современный взгляд на рынок микропроцессоров
- Новые процессоры Интел 12го поколения под кодовым названием Alder Lake
- Новые серверные процессоры под кодовым названием Sapphire Rapids
- Новый бренд будущей потребительской графики Intel ARC
- Новая система охлаждения для новых процессоров
- Обновление модельного ряда Intel NUC
- Intel Mobileye: Беспилотное такси скоро повезет первых пассажиров
- Вопросы и ответы

53 легендарных года успеха INTEL

В 1968, двое ученых, Роберт Нойс и Гордон Мур основали Intel чтобы развивать идею полупроводников.

В 1971 году, 50 лет назад Intel представил миру свой первый микропроцессор.

С тех пор Intel путем инноваций изменил мир компьютерных технологий и продолжает делать это и сейчас.



The Intel® 4004

Корпорация Интел

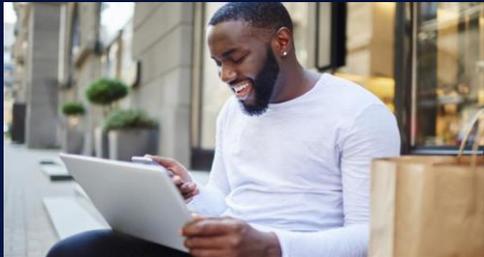
Наша цель

Мы создаем технологии, изменяющие мир, которые обогащают жизнь всех людей на планете.

Мы стремимся:

- стимулировать внедрение инноваций, которые делают мир безопасней, формируют здоровые и динамичные сообщества, а также повышают эффективность работы;
- использовать наши возможности по всему миру, чтобы делать общество, бизнес и планету лучше;
- прилагать усилия, чтобы мы и наши коллеги достигли более высокой степени ответственности, инклюзивности и устойчивости.

У нас большие амбиции, и мы все сильнее осознаем неотложность работы с другими и решения мировых проблем, с которыми никто не может справиться в одиночку.



Концепция

Стать безусловным лидером в отрасли и в полной мере раскрыть потенциал данных.



Миссия

Мы разрабатываем решения для преодоления самых серьезных вызовов, стоящих перед нашими клиентами, с помощью надежных вычислительных технологий от облака до периферии, основанных на законе Мура.



Инновации начинаются здесь



Scale AI Everywhere

Благодаря оптимизированной инфраструктуре данных, 10-100-кратному увеличению производительности популярных фреймворков и библиотек, а также нашим собственным уникальным инструментам, специалисты по искусственному интеллекту получают оптимизированное конвейерное масштабирование от рабочей станции до облака и периферии.



Converge 5G and Edge Development

5G и периферийные вычисления делают возможными новые классы приложений на заводах, в городах, больницах и многих других местах. Получите доступ к нашему набору контейнерных инструментов с открытым исходным кодом, поддерживающих виртуализацию, вычисления в реальном времени и логический вывод информации на периферийные устройства.



Get More Cloud App Performance

Наряду с партнерскими службами, оптимизированными для Intel, такими как блокчейн, Azure и Google, мы предоставляем технологии и инструменты для обеспечения максимальной производительности облачных приложений, такие как IPU для оптимизации оркестровки микросервисов, упрощенный доступ к телеметрии на основе машинного обучения и автоматическая настройка ПО в облаке.



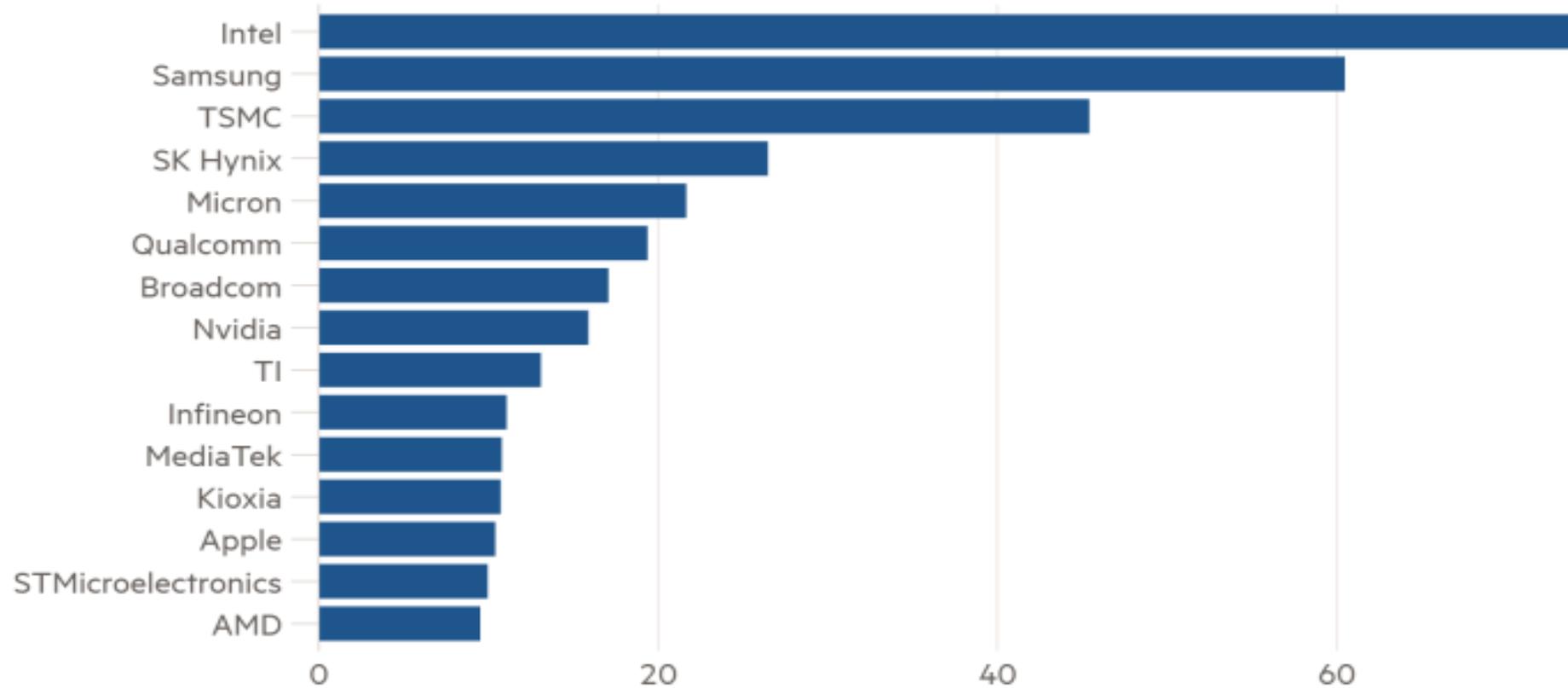
The Best Cloud-to-Client Experience

Вместе с такими партнерами, как Microsoft, Google и VMWare, наша миссия - обеспечить разработчиков оптимальной производительностью для облачных приложений во всем континууме «облако-устройство» - от объединения Windows и Linux приложений с применением ИИ до новых инструментов для создания современных веб-приложений.

Современный взгляд на рынок микропроцессоров*

Top semiconductor makers

By estimated revenues, 2020 (\$bn)



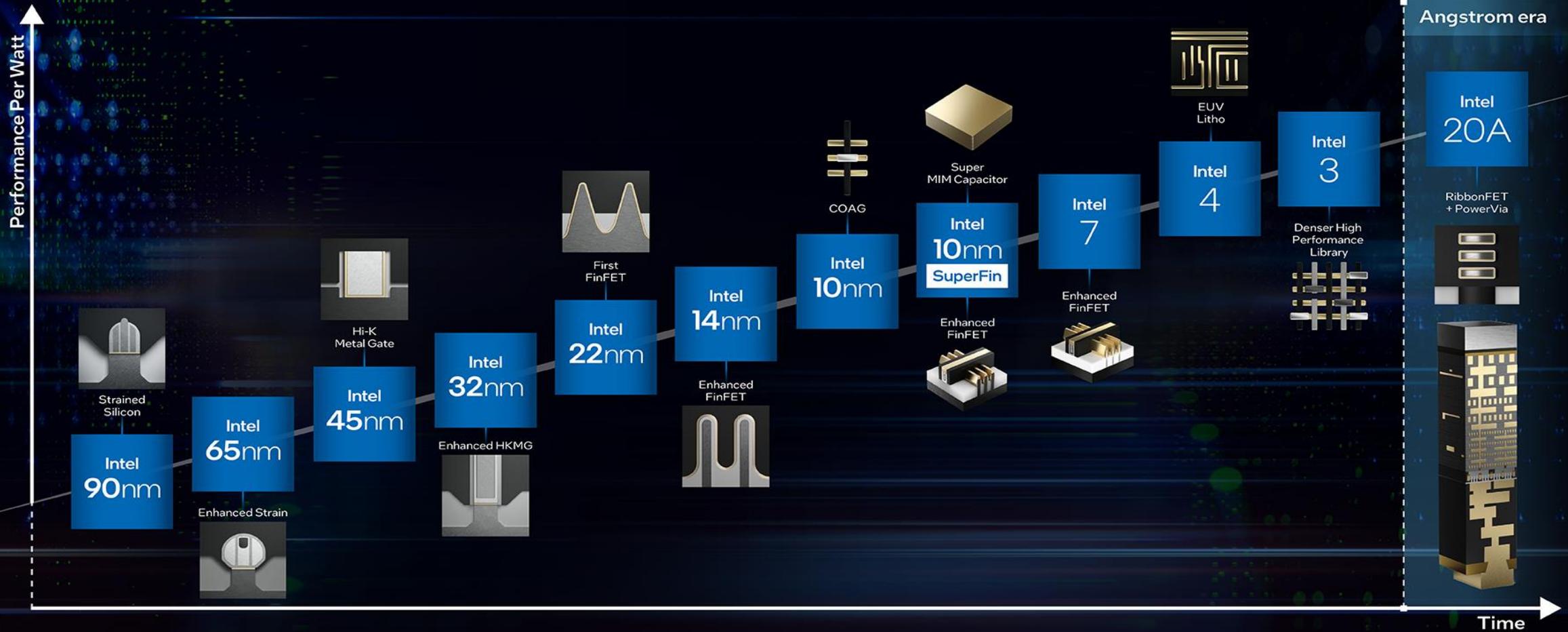
Source: IC Insights

© FT

*Статья в журнале Financial Times, источник IC Insights (2020)

Инновации в области технологических процессов

Intel Process Technology Innovations



intel.

accelerated

Источник: Конференция Intel Accelerated 2021

*Graphic is for illustrative purposes only and is not to scale

Представляем 12е поколение процессоров Intel® Core™

Разрушая представление о производительности

Представляем новейшее поколение процессоров Intel, обеспечивающих непревзойденную скорость и интеллект, сочетающее в себе потрясающие игровые возможности, продуктивность, творческие возможности, а также connectivity.



Новые процессоры Интел 12го поколения



Beginning Fall 2021

Alder Lake

Reinventing Multi Core Architecture

Single, Scalable SoC Architecture

All Client Segments – 9W to 125W – built on Intel 7 process

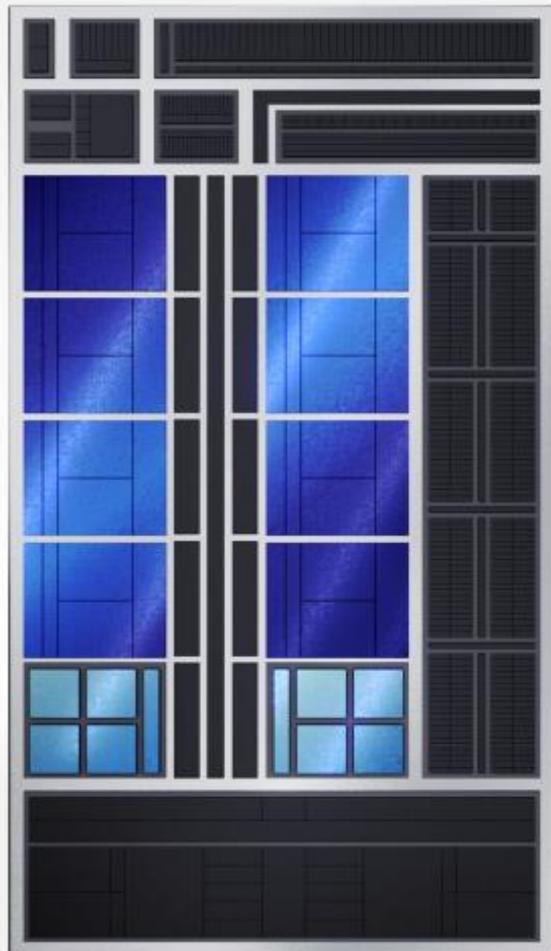
All-New Core Design

Performance Hybrid with Intel Thread Director

Industry-Leading Memory & I/O

DDR5, PCIe Gen5, Thunderbolt™ 4, Wi-Fi 6E

Новые процессоры Интел 12го поколения



Alder Lake Core/Cache

Up To

16 Cores

8 Performance
8 Efficient

Up To

24 Threads

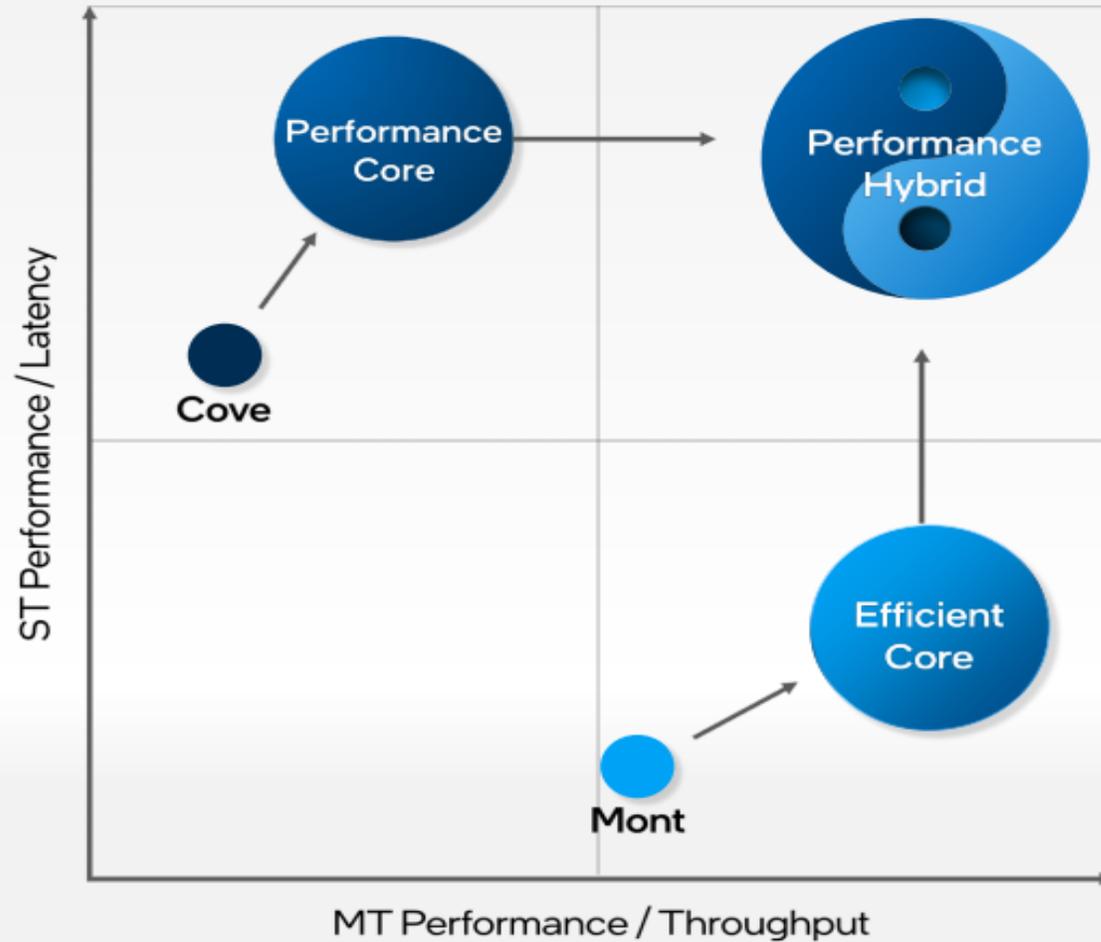
2T per P-core
1T per E-core

Up to

30MB

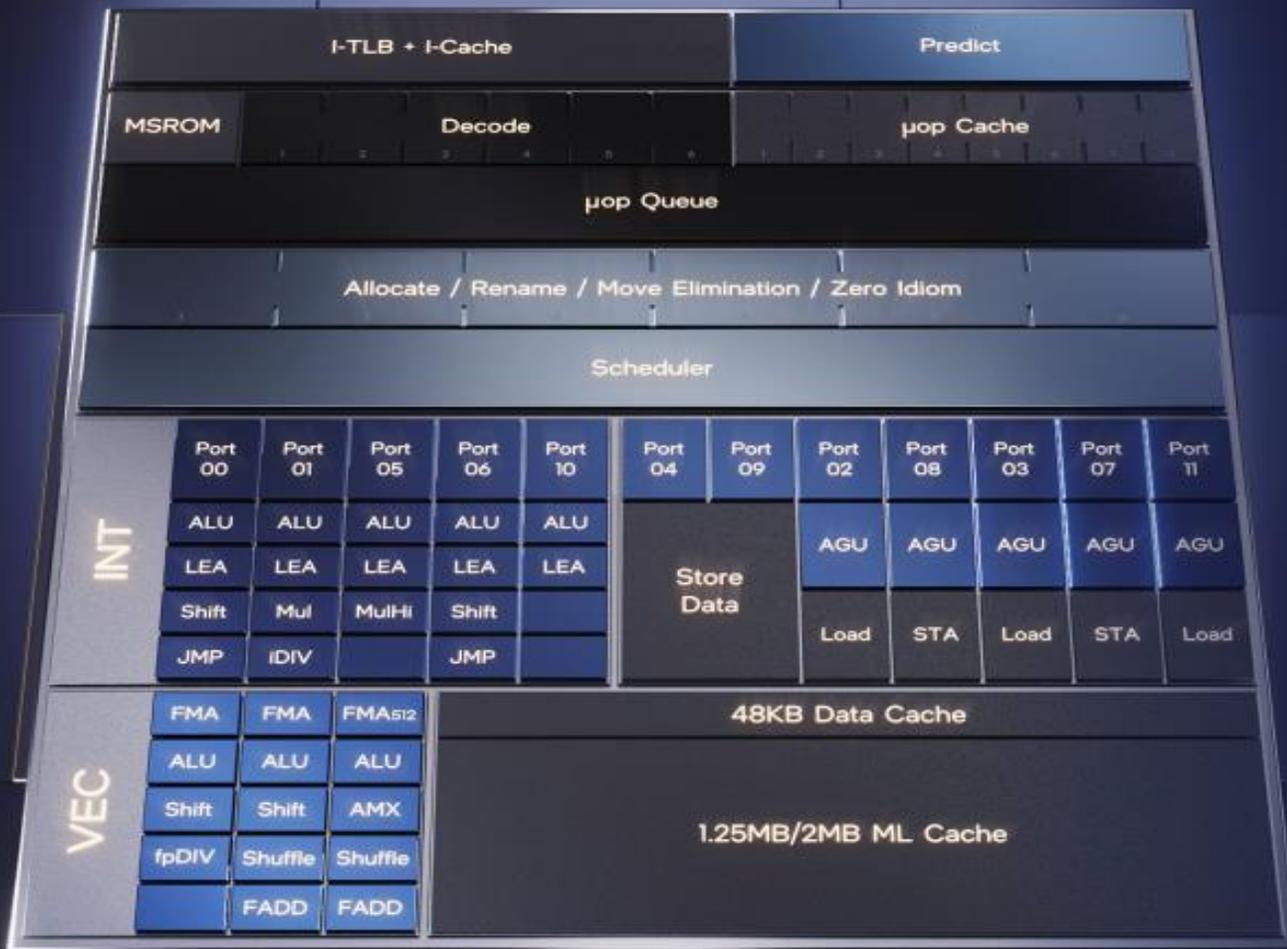
Non-inclusive
LL Cache

Новая архитектура ядер процессоров Интел



Graph is for conceptual illustration purposes only.

Новая архитектура ядер процессоров Интел



New

Performance

x86 Core

A Step Function in CPU Architecture Performance For the Next Decade of Compute

A significant IPC boost at high power efficiency

Wider Deeper Smarter

Better supports large data set and large code footprint applications

Enhanced power management improves frequency and power

Machine Learning Technology: Intel® AMX – Tile Multiplication

All in a tailored scalable architecture to serve the full range of Laptops to Desktops to Data Centers

Новая архитектура ядер процессоров Интел



Intel's **New** Efficient x86 Core Microarchitecture

Designed for throughput, enabling scalable multi-threaded performance for modern multi-tasking

Optimized for power and density efficient throughput with:

Deep Front-End
with on-demand length decode

Wide Back-End
with many execution ports

Optimized Design
for latest transistor technologies

Intel Thread Director

Направляет нужную рабочую нагрузку на нужное ядро в нужное время

Introducing

Intel Thread Director

Intelligence built directly into the core

Monitors the runtime instruction mix
of each thread and as well as the state of each core – with
nanosecond precision

Provides runtime feedback to the OS
to make the optimal scheduling decision for any workload
or workflow

Dynamically adapts guidance
based on the thermal design point, operating conditions,
and power settings – without any user input



Поддержка оперативной памяти DDR5

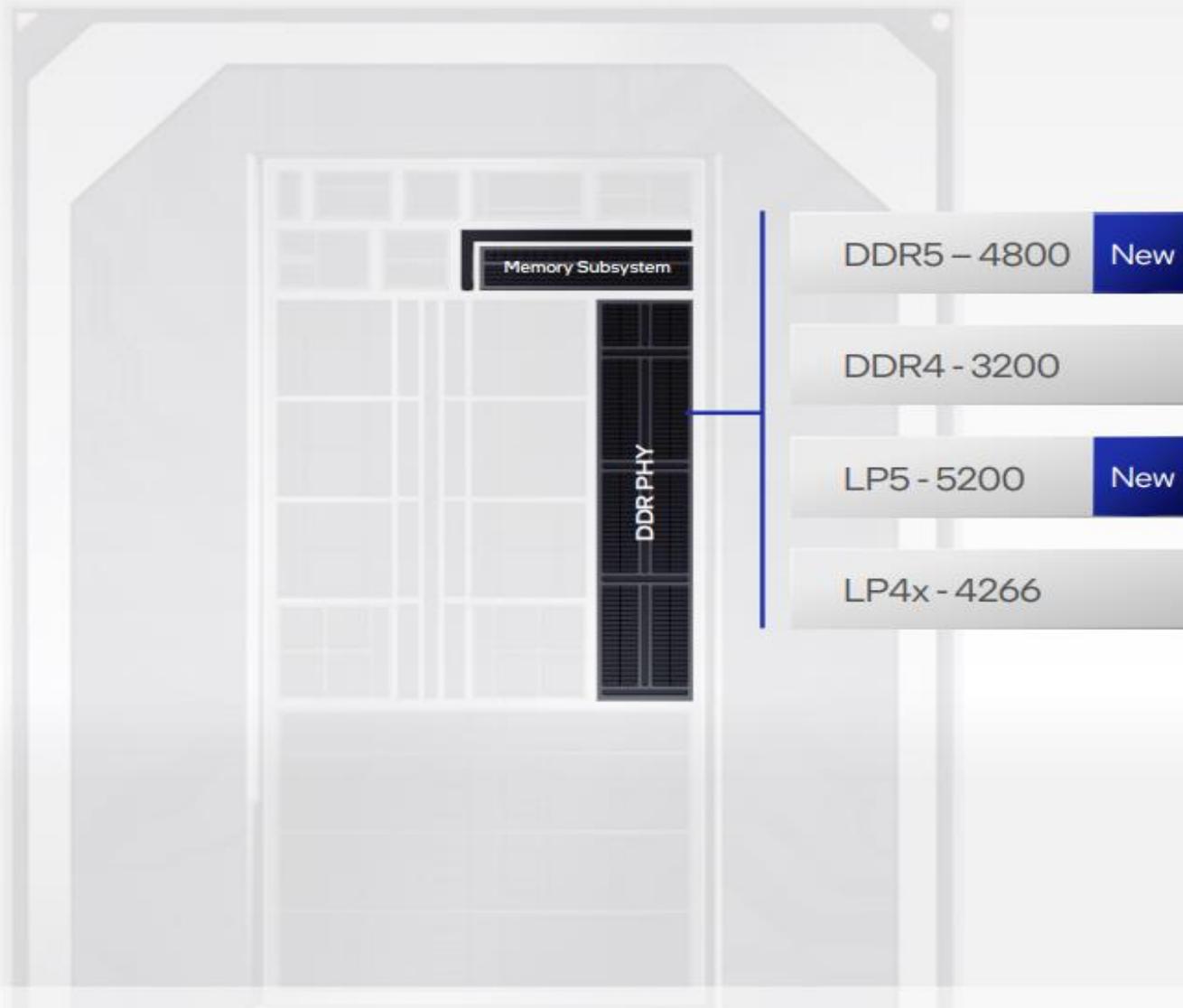
Alder Lake Memory

Leading the industry
transition to DDR5

Support for all four major memory
technologies

Dynamic voltage-frequency scaling

Enhanced overclocking support

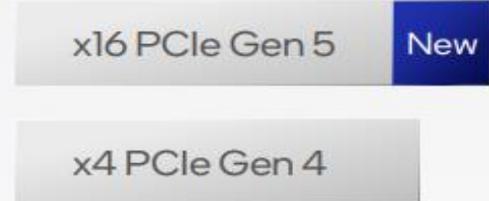
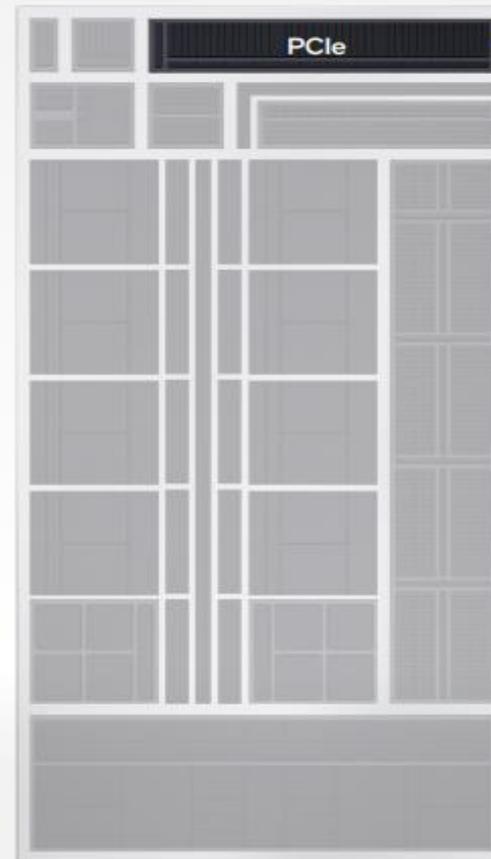
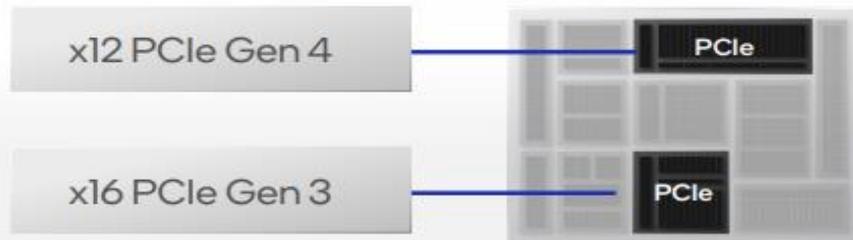


Поддержка интерфейса PCIe Gen5

Alder Lake PCIe

Leading the industry transition to
PCIe Gen5

Up to 2X bandwidth vs. Gen4
Up to 64GB/s with x16 lanes



Visit www.intel.com/ArchDay21claims for details

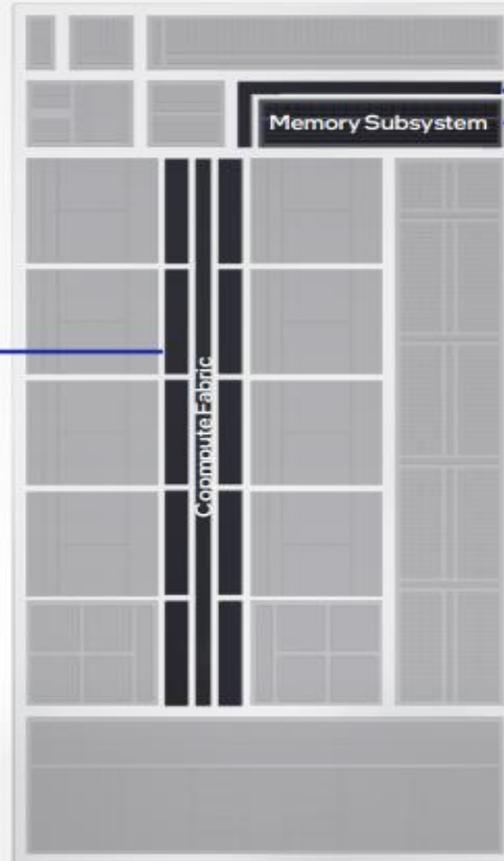
Новые возможности системы ввода-вывода (I/O)

Alder Lake Interconnect

Compute Fabric

Up to
1000 GB/s

Dynamic Latency
Optimization



I/O Fabric

Up to
64 GB/s

Real-time, demand-
based BW control

Memory Fabric

Up To
204 GB/s

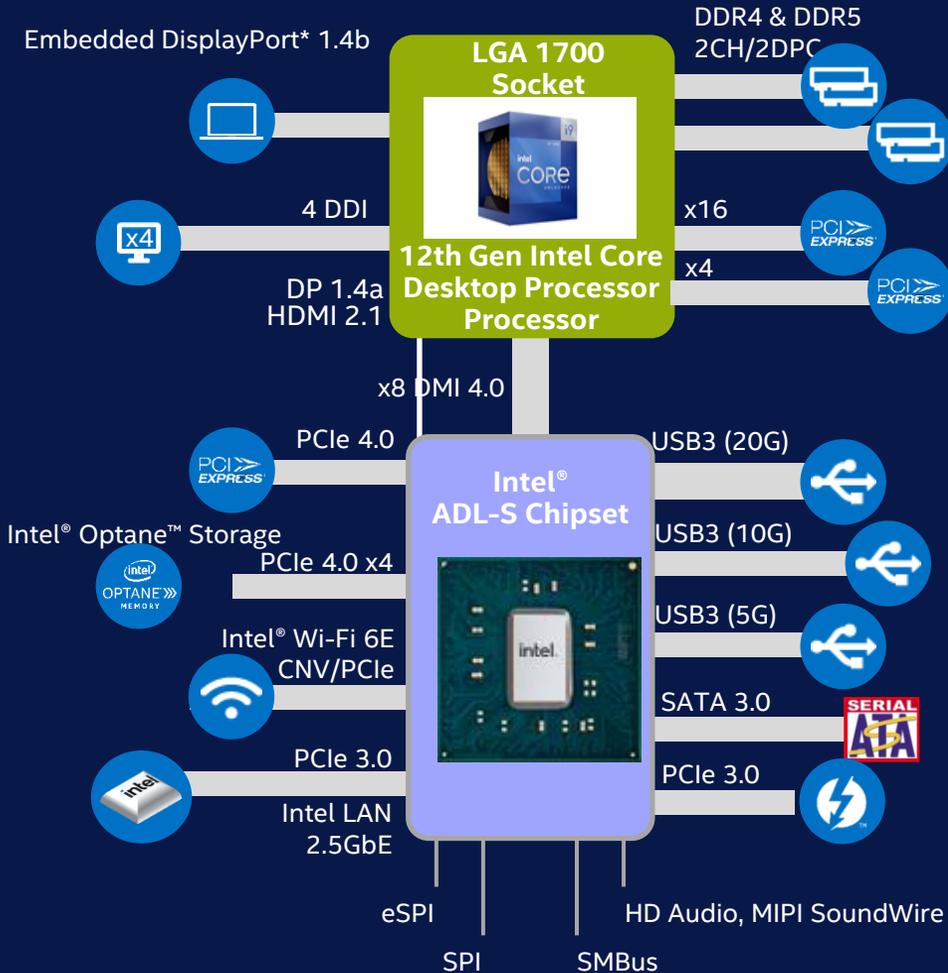
Dynamic Bus Width
& Frequency

Visit www.intel.com/ArchDay21claims for details

Новые процессоры Intel 12го поколения

«ЗАРЯЖЕННЫЕ» СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

- NEW Scalable Architecture with IPC Improvement
- NEW Performance-Cores + Efficient-Cores in a Single Processor for Highly Threaded Performance
- Intel® Deep Learning Boost (VNNI)
- Gaussian Network Accelerator
- ENHANCED Display Features for Premium Content Support via Xe Architecture
- ENHANCED Core & Memory Overclocking
- NEW Integrated Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) Support
- 2.5Gb Ethernet Discrete LAN



- NEW DDR5 (Up to 4800MHz)
Continue DDR4 (Up to 3200MHz)
- NEW CPU PCIe* 5.0 = 16 lanes⁴
- CPU PCIe* 4.0 = 4 lanes⁴
- x8 DMI 4.0 lanes
- NEW PCH PCIe* 4.0 lanes
- ADD'L USB3.2 Gen 2x2 (20G) ports,
PCIe* 3.0, SATA 3.0
- Discrete Intel® Thunderbolt™ 4
Maple Ridge (USB4 compliant)
- NEW with 12th Gen Intel Core Desktop
Processor Platform
vs. Rocket Lake-S Platform

Источник: <https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/core/12th-gen-processors.html>

CPU PCIe lanes are only validated for discrete graphics (x16) and PCIe storage (1x4). 1x16 bifurcated to 2x8 provides discrete graphics (x8) + additional storage configuration support (1x8).

Новые процессоры Интел 12го поколения

Возможности	Преимущества
Performance Hybrid Architecture	Гибридная архитектура, объединяющая производительные ядра (P-ядра) и эффективные ядра (E-Cores) для обеспечения сбалансированной однопоточной и многопоточной производительности в реальном времени
Intel® Thread Director	Оптимизирует рабочие нагрузки, помогая планировщику ОС разумно распределять рабочие нагрузки по оптимальным ядрам
PCIe 5.0 up to 16 Lanes	Обеспечивает скорость до 32 Гб/с для быстрого доступа к периферийным устройствам и сети до 16-ти полос PCIe 5.0
PCIe 4.0 up to 4 Lanes	До 16 Гб/с для быстрого доступа к периферийным устройствам и сети до 4-х полос PCI Express 4.0
Up to DDR5 4800 MT/s2	Эта первая в отрасли технология памяти поддерживает высокие частоты и широкую полосу пропускания, а также пропускную способность, ведущую к улучшению рабочего процесса и производительности
Up to DDR4 3200 MT/s2	Поддерживает более высокие частоты, более высокую полосу пропускания и лучшую пропускную способность для улучшения рабочего процесса и производительности
L3 and L2 Cache	Увеличенные размеры совместно используемого кэша Intel® Smart Cache (L3) и L2 обеспечивают большую память, высокую емкость и минимизируют задержки для быстрой загрузки игр и плавной частоты кадров
Intel® Deep Learning Boost	Ускоряет обработку и вывод результатов ИИ для повышения производительности глубокого обучения
Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0)	Обрабатывает речевые и аудио-приложения ИИ, такие как подавление нейронного шума при одновременном высвобождении ресурсов ЦП для повышения общей производительности системы
Intel® Turbo Boost Max 3.0	Определяет самые быстрые ядра процессора и направляет на них важные рабочие нагрузки
Intel® UHD Graphics driven by xE Architecture	Возможности мультимедиа и интеллектуальной графики повышают визуализацию, улучшают работу с 3D и обеспечивают более быструю обработку изображений
Overclocking Features and capabilities	В сочетании с набором микросхем Intel® Z690, процессорными ядрами P и E, графикой, и памятью Ваша система может быть настроена для работы на частотах выше спецификации процессора что приводит к более высокой производительности.

Новые процессоры Интел 12го поколения

Processor Number	Processor Cores (P+E) ³	Processor Threads ⁴	Intel® Smart Cache (L3)	Total L2 Cache	Processor Turbo Frequency			Processor Base Frequency		Unlocked ¹	Processor Graphics	Total CPU PCIe Lanes	Max Memory Speed ²	Memory Channels	Maximum Memory Capacity ²	Processor Base Power (W)	Maximum Turbo Power (W)
					Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz) ⁴	P-core Max Turbo Frequency (GHz) ⁵	E-core Max Turbo Frequency (GHz) ⁵	P-core Base Frequency (GHz) ⁵	E-core Base Frequency (GHz) ⁵								
Socket LGA 1700 Performance																	
i9-12900K	16 (8P + 8E)	24	30MB	14MB	Up to 5.2	Up to 5.1	Up to 3.9	3.2	2.4	√	Intel® UHD Graphics 770	20	DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s	2	128GB	125	241
i9-12900KF	16 (8P + 8E)	24	30MB	14MB	Up to 5.2	Up to 5.1	Up to 3.9	3.2	2.4	√	n/a	20	DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s	2	128GB	125	241
i7-12700K	12 (8P + 4E)	20	25MB	12MB	Up to 5.0	Up to 4.9	Up to 3.8	3.6	2.7	√	Intel® UHD Graphics 770	20	DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s	2	128GB	125	190
i7-12700KF	12 (8P + 4E)	20	25MB	12MB	Up to 5.0	Up to 4.9	Up to 3.8	3.6	2.7	√	n/a	20	DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s	2	128GB	125	190
i5-12600K	10 (6P + 4E)	16	20MB	9.5MB	n/a	Up to 4.9	Up to 3.6	3.7	2.8	√	Intel® UHD Graphics 770	20	DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s	2	128GB	125	150
i5-12600KF	10 (6P + 4E)	16	20MB	9.5MB	n/a	Up to 4.9	Up to 3.6	3.7	2.8	√	n/a	20	DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s	2	128GB	125	150

Поддержка памяти Intel® Optane™ Memory H20 + SSD

Впечатляющие возможности



Несколько вариантов расширения емкости



Продукт доступен с второго квартала 2021 года

Память Intel® Optane™ H20 - это твердотельный накопитель 2x2 PCIe Gen3 NVMe

Включает в себя модуль памяти Intel® Optane™, с контроллером нового поколения и технологией QLC NAND 3-го поколения.

Обеспечивает на 15% большую пропускную способность и на 15% меньшую задержку, чем твердотельные накопители на базе TLC NAND Gen4

Возможные варианты

32GB + 512GB

32GB + 1TB

Потрясающая производительность

Отлично подходит для обычных пользователей, геймеров и создателей контента

Обеспечивает лучшую производительность в реальном мире

Один форм-фактор M.2 2280
Обеспечение интеграции в форм-факторах настольных ПК AIO, Mini и Tower

Intel® Wi-Fi 6/6E (Gig+) + Intel® Killer Wi-Fi 6/6E (Gig+)

Новая эра сетевых подключений с технологиями Wi-Fi 6, стандарт IEEE 802.11ax

Больше высокоскоростных каналов передачи данных*



Режим ортогонального частотного мультиплексирования



Wi-Fi 6/6E (Gig+) это быстрая передача данных, улучшенная пропускная способность и яркие впечатления

Источник: [intel.com/wireless](https://www.intel.com/wireless)



Intel® Killer™ Networking это линейка проводных и беспроводных сетевых адаптеров с «убийственным» названием



Intel® Killer™ Networking – надежное подключение к Wi-Fi 6 / 6E для игр в режиме реального времени
Killer Prioritization Engine распознает игровой трафик и определяет приоритеты

Поддержка технологии Thunderbolt 4.0



Скорость передачи до 40 Гб/сек

8x

Быстрее чем
USB 3.0¹

4x

Больше граф.
пиксели чем в
HDMI 1.4¹

Широкие возможности подключения

- Подключение к любому устройству
- Один тип кабельного подключения
- Подключение двух дисплеев 4K или одного дисплея 5K



Яркие впечатления с Thunderbolt™ 4

Подключение через интерфейс USB-C

Connect to Everything



Simplify with one port to connect Thunderbolt devices, every display, and billions of USB devices

Game



Lighten your load while taking mobile gaming and virtual reality to the max

Dock



Access the fastest storage, two 4K displays and simultaneously charge with a single cable

Create



Speed your creation of multi-stream HD or 4K video and archive it with superfast storage

Один единственный порт – широкие возможности подключения

¹As compared to other PC I/O connection technologies including eSATA, USB, and IEEE 1394 Firewire*. Performance will vary depending on your specific hardware and software used. Must use a Thunderbolt™-enabled device. For more information go

Новая система охлаждения для новых процессоров

Новинка! Три решения по охлаждению для нового поколения процессоров Интел



intel.
CORE
i7

intel.
CORE
i5

intel.
CORE
i3



RH1

INTEL® LAMINAR RH1 COOLER

Corp. Brand

INTEL®



RM1

INTEL® LAMINAR RM1 COOLER

Product Name

LAMINAR



Fan Type + Level + Generation

RH1

RM1

RS1

RS1

INTEL® LAMINAR RS1 COOLER

Function

COOLER

Третье поколение семейства продуктов Intel® Xeon Scalable



intel®

Третье поколение серверных процессоров Intel Xeon



Up to 40 cores
per Intel Xeon Platinum processor

Up to 8 memory channels
at up to 3200 MT/s.

Features built-in AI acceleration (Intel DL Boost) with INT8 (VNNI) and bfloat16⁵ quantization for accelerated AI inference and training performance.

Features Intel SGX, **the most deployed trusted execution environment**, with up to 512GB enclave per processor.



Up to 32 cores
per Intel Xeon Gold processor

Up to 8 memory channels
at up to 3200 MT/s.

Featuring Intel SGX, **the most deployed trusted execution environment**, with standard SKUs supporting up to 64GB enclave per processor.



Up to 20 cores
per Intel Xeon Silver processor

Up to 8 memory channels
at up to 2667 MT/s.

Featuring Intel SGX, **the most deployed trusted execution environment**, with up to 8GB enclave per processor.

Третье поколение серверных процессоров Intel Xeon

Up to **6TB**

System Memory Capacity
(Per Socket) DRAM + PMEM

Up to **8CH**

DDR4-3200
2DPC (Per Socket)



Up to **40 Cores**
per processor

20%
IPC improvement
ISO Freq, ISO compiler

Advanced security solutions



Intel Software
Guard Extensions



Intel
Crypto
Acceleration



Intel Total
Memory
Encryption



Intel Platform
Firmware
Resilience

53%

Increase for HPC
workloads*

Scalable, flexible, customizable



Intel Deep
Learning Boost



Intel Speed Select
Technology



Intel
AVX-512



Optimized
Software

*See [108] at www.intel.com/3gen-xeon-config. Results may vary. See backup for configuration details.

Семейство продуктов Intel® ARC

intel®

intel®
ARC™

Новый бренд будущей потребительской графики



- Intel недавно представила бренд своей будущей потребительской высокопроизводительной графической продукции: Intel® Arc™.
- Торговая марка Arc будет охватывать оборудование, программное обеспечение и услуги и будет охватывать несколько поколений оборудования, при этом первое поколение будет основано на микроархитектуре Xe HPG под кодовым названием Alchemist (ранее известное как DG2).
- Intel также раскрыла кодовые названия будущих поколений под брендом Arc: Battlemage, Celestial и Druid.

Планы развития графических процессоров Интел

Multi-Year Roadmap

Performance ↑

Alchemist

X^e HPG

Q1
2022



Battlemage

X^{e2} HPG



Celestial

X^{e3} HPG



Druid

X^e Next Architecture



intel[®]
ARC™

Семейство продуктов Intel® NUC



intel®

Intel® NUC Element

U-Series Target Usage Scenarios



Smart Screens
(Digital Signage, Kiosks)

Modular Compute
(NUC, laptops, Mini PC)

H-Series Target Usage Scenarios



Gaming
(AAA Gaming, Streaming)

Workstation
(CAD, Content Creation)

Intel® NUC Extreme



Target Usage Scenarios



Gaming

Streaming

Content Creation

Intel® NUC Enthusiast



Target Usage Scenarios



Gaming

Streaming

Content Creation

Intel® NUC Performance



Target Usage Scenarios



Home Office

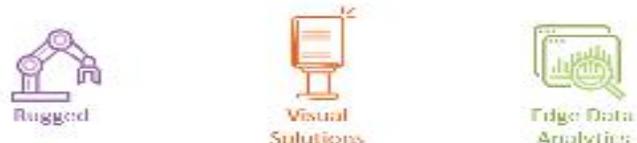
Home Theater PC

Casual Gaming

Intel® NUC Rugged



Target Usage Scenarios



Rugged

Visual Solutions

Edge Data Analytics

Intel® NUC Essential



Target Usage Scenarios



Kids Productivity

Streaming

Entry Signage

Новости Intel Mobileye

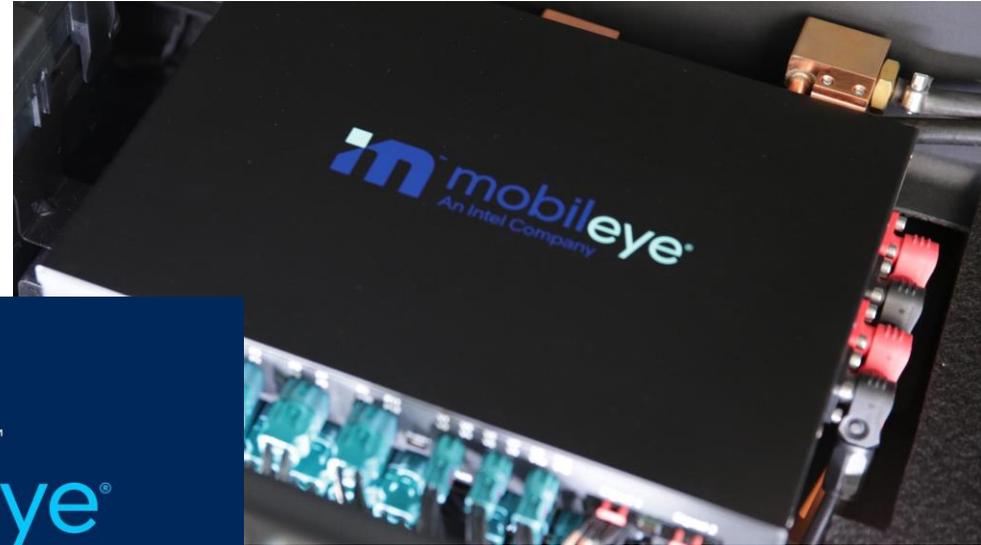
The Intel logo, consisting of the word "intel" in a lowercase, sans-serif font, with a small registered trademark symbol (®) to the right. The letter "i" has a small blue square above it.

intel®

The Mobileye logo, featuring a stylized white "m" with a blue square above the top left of the "m". Below the "m" is the word "mobileye" in a lowercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the right. Underneath "mobileye" is the text "An Intel Company" in a smaller, lowercase, sans-serif font.

mobileye®
An Intel Company

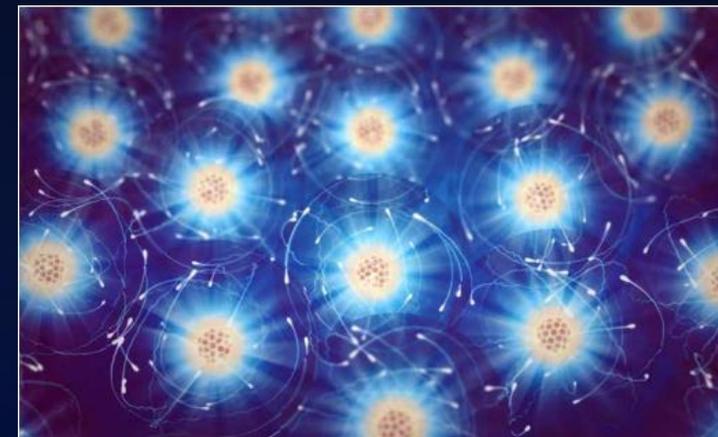
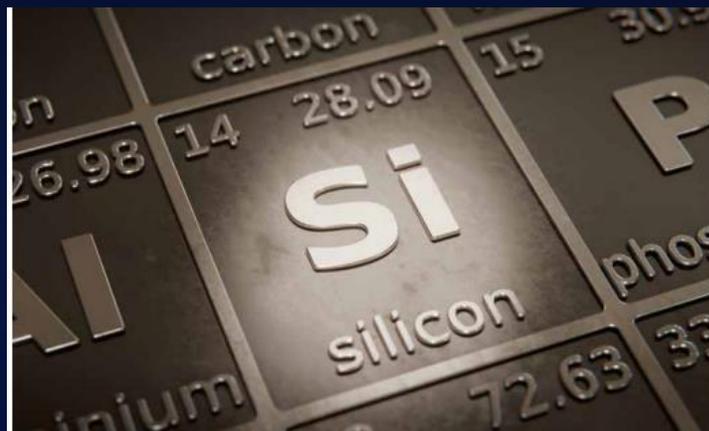
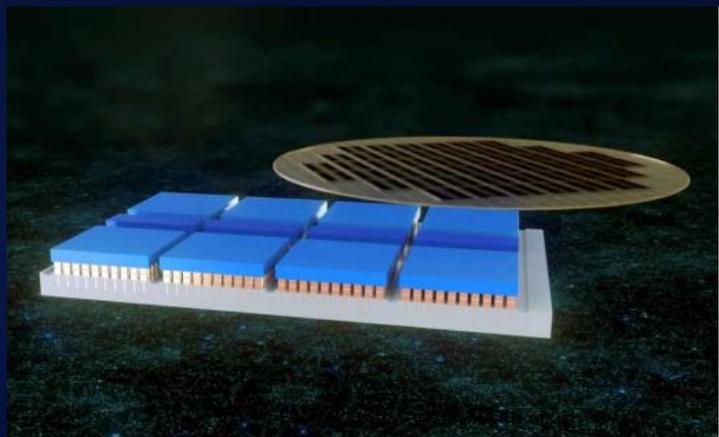
Беспилотное такси повезет пассажиров в 2022м году



Mobileye, подразделение компания Intel, сегодня представила готовый к работе электрический автономный автомобиль (AV) с 6 пассажирами, который будет использоваться для коммерческих услуг по вызову авто без водителя в Тель-Авиве и Мюнхене, начиная с 2022 года. Вы можете вызвать беспилотное такси с помощью мобильного приложения MoovitAV.



Строительные блоки для будущих вычислений



Увеличение количества транзисторов на кристалле и усовершенствование производства

Новые возможности для кремния

Восприятие квантового мира

Components Research, исследовательская группа департамента Intel Technology Development, отвечает за разработку революционных технологий производства и упаковки ЦПУ и других продуктов и технологий Intel, расширяющих действие закона Мура.

Другие предсказывают будущее,
в Intel мы его создаем.



Сейчас и в обозримом будущем мы будем совершенствовать компьютерные технологии и расширять возможности для того чтобы улучшить жизнь каждого человека на Земле

intel[®]

